

# 昆山东威科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位及人员名称	网上投资者	
调研时间	2024年5月27日	
会议地点	进门财经	
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：刘建波 副总经理、财务总监：周湘荣 董事会秘书：徐佩佩	
投资者关系活动内容记录	<p><b>主要问题：</b></p> <p>1. 关注到公司公众号发布跟深联电路的签约为公司发展历程中的“丰碑”，请具体介绍一下合作的产品及其重大意义所在？</p> <p>答：本次合作的设备主要是公司传统业务领域里处于龙头地位的VCP设备，设备因客户需求不同而有所差异，工艺先进，产品覆盖范围广泛，高阶HDI和高端高多层板均有涉及，广泛应用于包括AI算力等等领域。不过值得一提的是，在此次合作过程中，公司出售了一条二流体蚀刻线，可广泛用于高阶HDI、类载板、MiniLED等细线路细线距的蚀刻处理工艺，标志着公司在细线路工艺领域逐渐崭露头角，并将拥有一席之地。在近年PCB行业走势不佳、复苏缓慢的大环境下，公司能接到此订单，甚至也是公司VCP设备最大订单，这充分说明了下游客户的对公司设备的认可，体现了公</p>	

司在电镀设备中的行业龙头地位。

**2. 请介绍各主要业务今年以来的需求表现及展望？**

答：公司 2024 年至今 PCB 相关设备订单情况较好，较 2023 年回暖迹象明显，公司研发的水平镀三合一设备在行业中打破了国际单一进口设备商垄断、实现了国产替代，对我国人工智能产业链安全发展具有深远意义。公司看好未来几年 PCB 业务领域的订单。新能源领域，复合集流体设备合同按照客户要求有序推进，公司对未来复合铜箔产业的发展有较好的预期。公司设备类型丰富，技术储备雄厚，公司在现有技术及设备的基础上不断研发新设备，应用到新的行业与领域，未来公司将不断延伸产品应用领域，如钢铁、医疗器械、电池外壳、玻璃基板、IGBT 等应用场景。

**3. 请问今年至今 PCB 相关设备订单趋势情况，整体预期以及相比去年有所复苏的原因？**

答：公司 2024 年至今 PCB 订单情况较好，较 2023 年回暖迹象明显，公司也依旧看好未来几年 PCB 业务领域的订单。订单复苏的主要原因有以下几点：一、终端客户需求的变化，如算力、新能源汽车等增加了高阶 HDI、多层板等板的需求；二、下游客户陆续在东南亚新建生产基地，导致设备需求量的相应增加；三、3C 电子领域的去库存已有一定的成效。

**4. 请问公司的产品可用于玻璃基板吗？**

答：公司的陶瓷 VCP 和移载 VCP 都可以用于玻璃基板。

**5. 请问公司五金类电镀设备产品的订单和需求趋势？**

答：公司在五金类电镀设备上陆续有一些订单在增加，客户也在尝试设备新的应用场景。公司看好五金类

电镀设备的未来市场，对于智能化、清洁化、高端化生产的五金电镀设备充满市场信心。

**6. 公司应收账款增长幅度远高于收入增长幅度，一年期以上的应收账款占比过高，请问主要原因是什么？有什么应对措施？**

答：应收账款增长幅度高于收入增长主要系受行业景气度影响，客户回款有所延迟。公司各部门高度重视，将强化应收账款管理，扎实推进清收工作，降低应收账款。

**7. 复合铜箔行业的进展，下游客户在锂电池厂的订单情况？**

答：公司坚定地看好复合铜箔未来发展趋势，长期看复合铜箔具有明显的成本优势。公司积极开拓欧美、东南亚等地复合铜箔设备市场，目前已有客户陆续签订合同，复合铜箔产业化趋势值得期待。下游客户的订单情况建议直接咨询下游客户。

**8. 公司对复合铜箔的滚镀设备怎么看？和双边夹的对比？**

答：公司最开始研发复合铜箔设备就是采用的滚筒式导电，此为接触式电镀，容易影响铜层均匀度，降低良品率，遂进行了升级迭代，进而采用了公司专利技术的双边夹导电，实现无接触电镀，解决了滚筒导电方式的缺陷，有效提高了产品的良品率。

**9. 请简单介绍公司电镀铜设备出货进展？降本增效的情况如何？**

答：公司的光伏电镀铜设备已于2023年10月份出货，目前尚在客户处验证，需要时间来验证降本增效。公司将继续积极做好自身设备技术的提升，优化生产工艺，服务于下游客户的降本增效。

**10. 公司水平镀三合一、水平 DES 线等产品可**

生产人工智能服务器 PCB 产品，公司设备有何优势？在该行业是否属于打破国际垄断、实现国产替代？对我国人工智能产业链安全具有什么意义？

答：公司生产的水平镀三合一设备最大限度的降低了电镀之前化学铜层氧化的风险，实现了全自动化作业，减少了化铜后板子搬运和手动上板导致的板面刮伤等品质风险，同时也提高了生产效率，节省了人力成本。水平电镀采用多段水平清洗，清洗效果更好，节约了清洗水用量，减少了废水排放。水平 DES 线设备可实现全自动配槽、添加和槽体清洁，减少了人为失误导致的风险，降低了人力成本。该设备可根据客户不同的生产需求搭配独特的蚀刻技术。公司的水平镀三合一、水平 DES 线已获得客户认可并已验收通过，打破了国际单一进口设备商垄断、实现了国产替代。对我国人工智能产业链安全发展，打破国外进口设备垄断具有深远意义。

**11. 铜价和白银都暴涨，公司复合集流体设备以及光伏电镀铜设备进展如何了？什么时候可以有效降低成本实现量产？这两个细分分别供应了哪些公司？规模化量产时间公司预计什么时候可以到来？**

答：公司在复合集流体领域中开发有三款设备，分别为水电镀设备、磁控溅射设备及真空蒸镀设备。其中，生产复合铜箔的水电镀设备目前已处于成熟规模化量产阶段，自该产品问世以来，已有近百条订单支撑；磁控溅射 12 靶设备已有出货，24 靶设备在原有设计的基础上进行优化调整，为客户试生产中。复合铝箔上，真空蒸镀设备已完成几轮厂内打样，效果较好，争取尽快完成设备终调。光伏镀铜领域，公司的电镀铜设备尚在客户处验证，需要时间来验证降本增效。公司对复合集流体领域及光伏领域的电镀设备产业化充满信心，公司将持续做好自身设备技术的提升，优化生产工艺，服务于下游客户的降本增效。

附件清单	无
日期	2024年5月27日